

证券代码：688439

证券简称：振华风光

贵州振华风光半导体股份有限公司

投资者关系活动记录表

编号：2026-002

投资者关系活动类别	☒ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☐ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他
参与单位名称	开源证券股份有限公司
时间	2026 年 8 月 4 日
地点	公司五楼会议室
上市公司接待人员姓名	副总经理刘健； 副总工程师邹泽勇； 副总工程师张子扬； 董事会办公室主任杨涓禾。
	问题 1:成都、西安、上海新设分公司建设进度如何？原南京研发中心职能如何安排？ 答：公司董事会已审议通过设立上海、西安、成都三家分公司相关议案。目前正有序推进三家分公司工商注册、账户开立、人员劳动关系转移等各项前期筹备工作。本次组织架构调整中，原南京研发中心相关研发业务、人员资源整合纳入成都分公司统筹运营，原南京研发中心不再保留。公司稳步落实异地研发网点优化，做好员工宣导与用工衔接，平稳推进组织模式过渡，持续完善全国研发布局，更好吸引区域研发人才，支撑技术研发与市场拓展。

	问题 2:请问公司目前在手订单的情况? 答: 公司目前在手订单,符合“十五五开局阶段”的整体行业情况。 问题 3:公司先进封装、系统级封装技术落地情况,能否支撑产品迭代? 答: 公司具备系统级封装设计能力,配套高可靠集成电路封装研发条件,支撑多品类信号链、电源类产品小型化集成需求。相关技术持续迭代,根据客户需求开展定制化方案开发。 问题 4: 公司有无对外拓展民品市场规划,如何平衡特种领域与民用市场资源投入? 答: 公司以高可靠集成电路为主业,在稳固传统优势市场基础上,稳步探索商业航天、电力、医疗电子等民用高可靠市场;合理统筹研发资源,持续丰富产品谱系,培育新增长点。 问 5: 可以介绍一下公司存储芯片的技术储备,主打产品和销售情况吗? 答: 公司深耕高可靠集成电路赛道,已掌握多类存储芯片核心设计、可靠性加固与自研固件技术,技术储备覆盖 NOR/NAND、DDR、EEPROM、eMMC 等存储架构。主打适配严苛工况的宽温高可靠存储芯片,已有约十款产品完成转产验证并实现小批量订货。公司将紧跟市场需求与产业政策导向,持续推进存储新品迭代与市场拓展。 问 6: 公司抗辐照芯片具备哪些技术优势?同时请介绍 RISC-V 架构 MCU 研发进展,产品是否具备抗辐照能力,主要面向哪些应用场景,相关产品航天领域验证及供货情况如何? 答: 公司长期深耕高可靠集成电路赛道,积累了成熟的抗辐照加固设计技术,产品可满足商业航天等高可靠场景严苛环
--	---

	境要求。同时公司依托自身抗辐照技术优势布局 RISC-V 架构高可靠 MCU 研发，产品面向商业航天、特种装备等高可靠领域开展研制与验证工作。相关产品持续推进客户型号验证，具体配套项目、订单信息及业务细节如达到披露标准，公司将依规及时履行信息披露义务。 注：上述问题所涉及的业务，均可能受政策及市场因素影响，因此不构成业绩承诺，请投资者理性决策，注意投资风险。
关于本次活动是否涉及应当披露重大信息的说明	本次活动，公司严格按照相关规定交流沟通，不存在未公开重大信息泄露等情形。
附件清单(如有)	无
日期	2026 年 8 月 6 日